

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE PRÉPARATION D'UN ÉCHANTILLON DE DIAGNOSTIC DE CIRCUIT INTÉGRÉ

Avantages technologiques

Flexible :

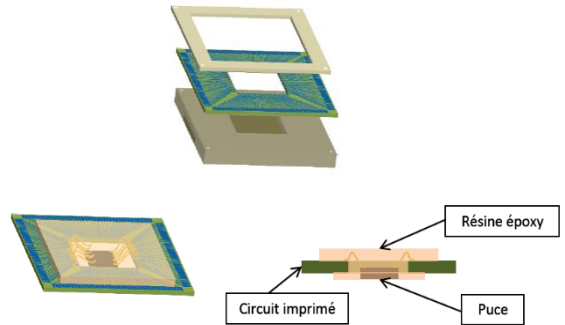
- Applicable à tous types de circuits intégrés boîtier plastique ou céramique

Performant :

- Possibilité d'alimenter le circuit intégré durant l'analyse et le diagnostic
- Risques réduits de destruction du circuit

Simple :

- Procédé rapide et à faible coût



Vue schématique du procédé de préparation d'un échantillon

Synthèse de l'invention

L'invention concerne un dispositif de préparation d'échantillon de diagnostic de circuits intégrés. La localisation des défauts dans les circuits intégrés nécessite un accès optique à la face arrière de la puce pour analyser le substrat silicium de manière non destructive.

L'invention propose une méthode pour enlever puis mettre le composant dans un nouveau boîtier sur un montage de type « Chip On Board » avec un moulage époxy dans un réceptacle métal aluminium ou nickel réutilisable.

Elle permet ensuite un polissage parallèle comme c'est le cas pour les assemblages de type FLIP CHIP

Bénéfices commerciaux

- Système :
 - Économique
 - Simple
 - Versatile

Applications potentielles

- Analyse de tous types de circuits intégrés

Invention brevetée disponible sous licence.